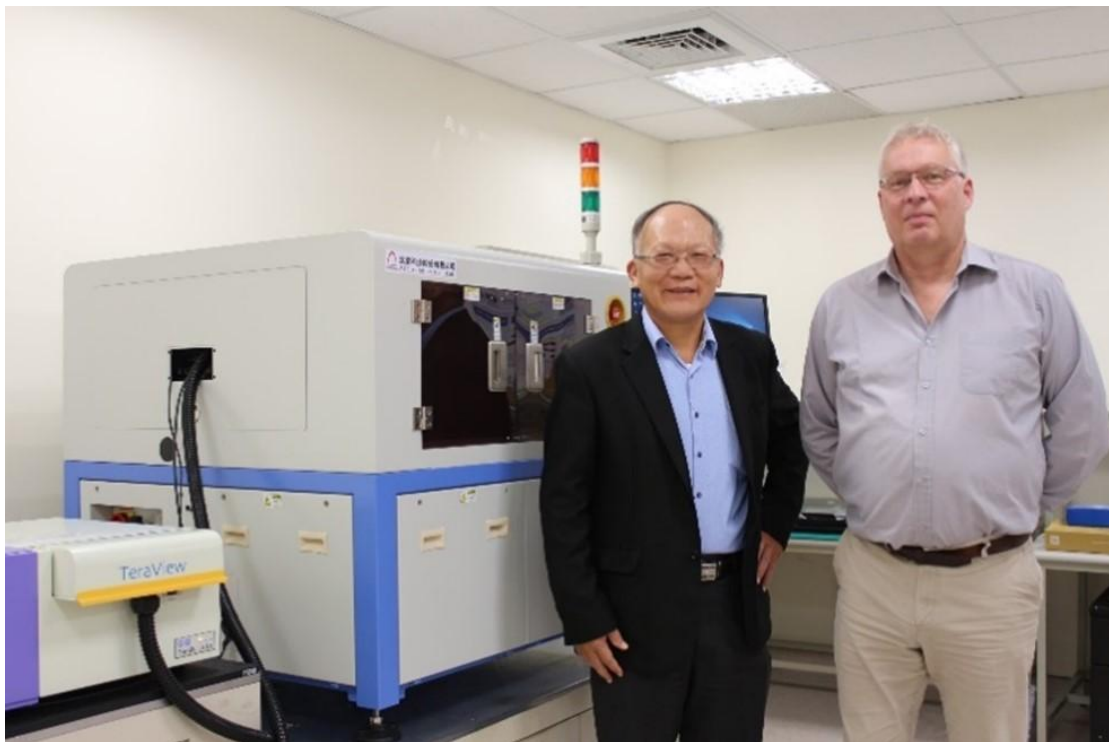


筑波科技推出 TZ6000 滿足非破壞性檢測市場需求

2023-03-13 筑波科技

位在竹北生醫園區，以提供測試解決方案的領導者和供應商，滿足通訊元件、設備和系統製造商客戶需求的筑波科技（ACE Solution），宣布推出 TZ6000，此係一種用於化合物半導體的非破壞性晶圓品質測量方案。結合 TeraView 的 TeraPulse Lx 技術，針對厚度、折射率、電阻率、介電常數、選定位置的表面/次表面缺陷和整個晶圓掃描達成非破壞性晶圓品質測量。

筑波科技研發副總陳治誠博士（JC Chen）表示，半導體晶圓的品質決定終端設備可達成的最大轉換效率。晶圓表面加工過程包括粗磨、精磨和化學機械拋光，很容易引起次表面損傷（SSD）。目前仰賴 VIS/IR/UV 光學檢測的晶圓檢測系統雖可分析晶圓的表面特性，但因為穿透深度較低，不能分析 SSD。太赫茲（THz）針對半導體晶圓能比矽、碳化矽和氮化鎵有更高的穿透深度。筑波以 THz 技術開發 TZ6000，滿足化合物半導體晶圓非破壞性檢測的市場需求。



TZ6000 System 結合 TeraPulse Lx，應用於化合物半導體之非破壞性晶圓品質測試。左為筑波科技董事長許深福，右為 TeraView 首席科學家 Dr. Philip Taday。
（圖／筑波科技提供）

ACE 筑波科技-電子量測方案供應商 ACE RF Integrated Solution Provider

電子儀器/WLAN測試整合專家



筑波科技股份有限公司
ACE. Solution Co., Ltd.

台灣: +886-3-5525633#3801 / 3800
蘇州: +86-512-89188620
深圳: +86-755-29351095

www.acesolution.com.tw / service@acesolution.com.tw



TeraView 應用主席兼首席科學家 Philip F. Taday 博士強調，TeraPulse Lx 系統是 TeraView 世界領先的太赫茲分析系列，能滿足成像或光譜應用中材料檢測的需求，是化合物半導體產業的理想選擇。該系統的模組化架構和 TeraView 專利研發之激光門控光電導發射器、檢測器，為使用者提供靈活性和可擴展性，標準配置系統更具備領先的 3,200 ps 時間延時線。

筑波科技董事長許深福 (Steve Hsu) 分享，本公司是電氣精密測試、集成服務和解決方案的領先者，與 TeraView 合作將本公司優勢發揮在 TeraPulse Lx 模塊整合到 TZ6000 系統，以進行非破壞性晶圓品質檢測。TZ6000 之高靈活性可適用各種尺寸和形狀的晶圓，配有筑波獨特的多元晶圓探頭及智慧化軟體演算分析功能，用於同時測量晶圓表徵的多個參數。TZ6000 具有使用者易懂的圖形說明軟體，用於晶圓製造和研發過程的品質檢測。

TeraView 首席執行官 Don Arnone 博士總結，此方案是 TeraView 與筑波科技密切合作開發的另一領先里程碑，雙方秉持高度信心將該產品用於化合物半導體晶圓品質分析和缺陷檢測。TeraPulse Lx 系統有一輕巧緊密的核心單元設計，易於不同地點運輸。結合 TeraView 的 TeraPulse Lx 模塊，可透過此產品滿足化合物半導體晶圓產業大幅成長的需求。

ACE 筑波科技-電子量測方案供應商 ACE RF Integrated Solution Provider

電子儀器/WLAN測試整合專家



筑波科技股份有限公司
ACE. Solution Co., Ltd.

台灣: +886-3-5525633#3801 / 3800

蘇州: +86-512-89188620

深圳: +86-755-29351095

www.acesolution.com.tw / service@acesolution.com.tw

